安达智能 20260902

安达智能：平台化转型切入 AI 服务器组装，百亿级新赛道驱动业绩爆发

摘要

- 业务从 SMT 后段延伸至 FATP 组装，目标市场空间由 10 亿级跃升至百亿级，单线价值量显著提升。
- ADAI 智能平台采用模块化设计，解决 FATP 小批量、快迭代痛点，缩短换线时间并提高设备复用率。
- AI 服务器组装自动化为核心增量，NVIDIA 试验线已落地，预计 2027 年市场规模达 50-100 亿元。
- 客户结构集中，苹果营收占比约 60%，正凭借项目经验向 AI 服务器、高速光模块等新兴领域渗透。
- 2026 年营收目标 7.5 亿元，随 AI 服务器自动化布局进入收获期，远期利润潜力达 10 亿元，目标市值 200 亿元。
- 业绩拐点初现，单季度数据已回正，研发高投入期后随新产品放量，报表端净利润有望迎来显著释放。

Q&A

请介绍一下安达智能的主营业务、产品矩阵及发展历程？

公司的核心业务是流体控制设备，最初以点胶机为切入点，于 2008 至 2010 年间进入市场，并较早开发出全自动多功能高速点胶机。在 2011 至 2017 年期间，公司围绕点胶技术，将产品线延伸至涂覆、等离子清洗、固化等设备，形成了多品类的设备矩阵。自 2018 年以来，公司进一步拓展业务边界，涉足 ADAI 智能平台、智能检测、超快激光及 5G 机床等领域，实现了从单一设备供应商向多工艺、平台化解决方案提供商的转型。其主要产品应用于 SMT（表面贴装技术）后段工艺，即 PCBA（印制电路板组装）制造过程中的点胶、涂覆、固化和清洗等环节。近年来，公司也已将业务拓展至 FATP（最终组装、测试和包装）的组装设备领域。

公司的 ADAI 智能平台有何特点，它主要解决了制造业的哪些痛点？

ADAI（Andar Device AI）智能平台是一种柔性化、模块化的设备解决方案。该平台基于一个通用的底座，通过加装不同的功能模块，如输送、工艺处理、供料、检测及其他辅助模块，并结合软件系统，最终形成一台完整的设备。相较于传统的专用设备，ADAI 平台特别适用于多品类、小批量、快速迭代的 FATP 组装场景。

核心优势在于能够显著缩短客户的换线调试时间，提高设备的复用率，从而推公司从单机设备供应向平台化解决方案升级。该平台旨在有效解决传统制造业面临的四大痛点：设备通用性低、故障排除时间长、操作技术门槛高以及转线换产不灵活。

公司当前的股权结构、财务状况以及股权激励目标是怎样的？

公司的股权结构相对集中，创始人夫妇合计持股比例超过 60%。从财务数据看，过去几年公司收入增长较为平缓，主要原因是传统消费电子领域的资本开支有限，行业进入成熟期。同时，公司为开拓新产品进行了较高的研发投入，费用率较高，这在一定程度上影响了报表端的净利润表现。公司于 2024 年推出了限制性股票激励计划，其中 2025 年的营收目标约为 7 亿元，该目标基本达成。2026 年的营收目标设定为 7.5 亿元，但鉴于第二季度的高速增长，实际情况预计会更好。

公司主要的客户构成是怎样的，以及在服务头部客户的过程中积累了哪些核心能力？

公司的客户覆盖消费电子、汽车电子、家电、工控和通信等多个领域。其中，苹果是公司过去几年最大的单一客户，其收入占比基本维持在 60%左右。此外，公司也服务于立讯精密、富士康等苹果的 EMS 厂商，以及比亚迪、特斯拉等汽车电子客户。通过长期服务这些头部企业及其 EMS 厂商，公司在新品导入、工艺验证、定制化开发和现场交付等方面积累了强大的项目能力。这些能力为公司向 AI 服务器等新兴市场领域拓展奠定了坚实基础。

公司业务从 SMT 后段延伸至 FATP 组装环节，这一拓展对公司的市场空间和价值量有何影响？

公司过去的业务主要集中在 SMT 后段，这是一个年市场空间约 10 亿元级别的设备市场。通过将业务延伸至 FATP 组装段，公司进入了一个市场空间可达百亿级别的领域。在传统的消费电子领域，FATP 已有成熟的供应商，但在服务器和光模块等新兴领域，自动化程度先前几乎为零。因此，随着这些新领域开始采纳自动化和柔性化生产，对相关设备的需求将大幅增加。这一战略拓展使得公司在单条产线或单个客户中的设备价值量得到显著提升，构成了公司主要的成长来源。

AI 服务器组装自动化为公司带来了哪些新的市场机遇？其市场规模和发展前景如何？

AI 服务器组装自动化是公司面临的重大机遇。传统服务器生产流程中，L6 到 L10 的工序，如插装、锁付、搬运、线缆连接、视觉检查和功能测试等，主要依靠人工完成。未来，这些工序有望通过自动化设备实现。对于 NVIDIA 等客户而言，芯片产品从 B 系列到 Rubin 再到后续的 Feynman 系列不断迭代，采用柔性化自动化设备只需更换部分模块即可适应新产品，无需重建整条产线。NVIDIA 推动服务器组装自动化的核心原因在于提升生产效率、产品一致性和良率，并契合其“AI 工厂”的自动化理念。目前，NVIDIA 已在部分组装厂部署了一至两条试验线，预计到 2027 年将有更多产线转向自动化。若 2027 年行业新增 100 条组装产线，每条产线的设备价值量预计在 5,000 万元至 1 亿元之间，整体市场规模可达 50 亿至 100 亿元。考虑到 Google、AWS 等其他云厂商也在探索服务器组装自动化，整个市场规模有望达到百亿级别。

除了 AI 服务器，公司在光模块、传统 3C 以及其他新兴领域还有哪些业务增长点？

在 AI 相关领域，高速光模块是另一个重要的增长点。自动化设备可应用于光模块的 PCBA 制造、组装以及测试验证环节。随着立讯精密等厂商推进自动化组装产线，相关设备需求预计将显著增加。在传统 3C 领域，尽管行业成熟，但每年新产品的发布、端侧 AI 创新（如 AI 眼镜、OpenAI 的端侧硬件）以及苹果产品线的年度更新，仍会持续带来对 3C 零部件自动化设备的需求。此外，公司在氢能源等非消费电子领域也有业务布局。综合来看，这些领域共同构成了公司未来的多元化增长动力。

综合来看，公司未来的业绩增长潜力和市值空间如何？

公司在消费电子领域积累了深厚的技术和行业经验，并成功把握了 AI 服务器组装自动化的发展机遇。随着公司在 AI 服务器和光模块等领域的布局进入收获期，预计明后年（2027-2028 年）业绩将迎来非常明显的释放。从季度数据看，公司业绩已开始回正。基于对未来 AI 服务器自动化市场百亿级规模的判断以及公司目前有利的卡位优势，预计公司未来的收入和利润将实现显著增长，利润规模有潜力达到 10 亿元级别。因此，公司的合理市值有望达到 200 亿元。

人在草木间